**企业技术难题及合作意向表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 中芯国际 | | |
| **详细地址** | 北京经济技术开发区文昌大道18号 | | |
| **意向合作中科院单位** | |  | |
| **所属产业类别** | □新一代信息技术产业 □新能源汽车与智能网联汽车产业 □生物技术与大健康产业 □机器人与智能制造产业 √其他，请说明 集成电路 | | |
| **企业简介** | 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，包括逻辑芯片，混合信号/射频收发芯片，耐高压芯片，系统芯片，闪存芯片，EEPROM芯片，图像传感器芯片电源管理，微型机电系统等。 | | |
| **技术需求** | **技术需求名称** | | **需求详情、技术基础及合作意向** |
| IMP 多层膜静电吸盘的陶瓷板制造 | | 1, 电极和陶瓷板结合；多层膜烧结工艺；coating层材料分析；局部导通电阻>10MΩ；表面粗糙度<0.006Ra;膜层均匀度<10μm；陶瓷表面的镀层，存在应力，会导致膜脱落，多层膜叠加均匀度难以保障，膜层表面粗糙度0.2微米；  2, 应用在半导体离子注入工艺,应用温度-110~200℃；  3，有相关生产测试设备；  4，有静电吸盘经验，且涉及到离子植入工艺的研究院所； |
| **预期取得的主要成果和效益** | 1、开发出离子注入设备使用的高端静电吸盘复合涂层；  2、预期可开发出专用镀膜设备；  3、打破国外技术垄断；  4、形成专利技术。 | | |
| **希望政府部门协调解决的问题和相关建议** | 1，推荐资历深厚的研发团队；  2，科研院所给出规划开发周期，商议时间安排合理性，时间就是半导体厂的命脉  3，研发成果和知识产权划分，明确研究院所和厂商的分配比例； | | |